

# Inhaltsverzeichnis

## Kurzvorträge Posterblock 1

<b>1 Large-area deposition of thin crystalline MoS<sub>2</sub> films on 200 mm wafers using plasmaassisted atomic layer deposition .....</b>	<b>8</b>
J. Jagosz <sup>1</sup> , L. Willeke <sup>1</sup> , M. Becher <sup>1</sup> , A. Ostendorf <sup>1</sup> , P. Plate <sup>2</sup> , C. Bock <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Ruhr-Universität Bochum; <sup>2</sup> Sentech Instruments GmbH, Berlin	
<b>2 Heterointegration von III-V basierten Resonanztunneldioden Oszillatoren/Detektoren und Heterobipolartransistor MMICs für kompakte THz Module .....</b>	<b>12</b>
C. Preuss, R. Kress, E. Mutlu, K. Müller, A. Poßberg, W. Prost, N. Weimann, Universität Duisburg-Essen	
<b>3 Rapid thermal annealing and reduction process monitoring of graphene oxide thin film on chip.....</b>	<b>17</b>
H. Amiri <sup>1,2</sup> , A. Nikookhesal <sup>1</sup> , D. Murugan <sup>1</sup> , S. Scholz <sup>3</sup> , M. Frentzen <sup>3</sup> , Y. Cao <sup>1</sup> , X. T. Vu <sup>1</sup> , U. Schnakenberg <sup>1</sup> , V. Sai <sup>4</sup> , M. S. Narayanan <sup>5</sup> , J. Knoch <sup>3</sup> , S. Ingebrandt <sup>1</sup> , V. Pachauri <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> RWTH Aachen University; <sup>2</sup> Politecnico di Milano, Italy; <sup>3</sup> RWTH Aachen University;	
<sup>4</sup> Indian Institute of Technology Madras, India; <sup>5</sup> Indian Institute of Technology Madras, India	
<b>4 Cu particle free inks for printed electronics application-challenges and solutions.....</b>	<b>21</b>
N. Mohan, R. Saccon, S. K. Bhogaraju, G. Elger, Technische Hochschule Ingolstadt	
<b>5 Cu sintering for high power electronics packaging – challenges and solutions.....</b>	<b>26</b>
R. Saccon, S. K. Bhogaraju, G. Elger, Technische Hochschule Ingolstadt	
<b>6 Laserinduzierte Verringerung des Metall-Graphen-Kontaktwiderstands.....</b>	<b>32</b>
V. Jangra <sup>1</sup> , S. Kataria <sup>1</sup> , M. C. Lemme <sup>1,2</sup>	
<sup>1</sup> RWTH Aachen University, <sup>2</sup> AMO GmbH, Advanced Microelectronic Center Aachen	
<b>7 Graphen/Cyanin-Farbstoff-basierte hochempfindliche flexible Photodetektoren .....</b>	<b>37</b>
B. Uzlu <sup>1,2</sup> , S. Stoll <sup>1,2</sup> , O. Yakar <sup>1,2</sup> , D. S. Schneider <sup>1</sup> , E. M. Özalp <sup>1,2</sup> , D. Neumaier <sup>1,3</sup> , S. Balci <sup>4</sup> , Z. Wang <sup>1,2</sup> , M. C. Lemme <sup>1,2</sup>	
<sup>1</sup> AMO GmbH, Advanced Microelectronic Center Aachen; <sup>2</sup> RWTH Aachen University;	
<sup>3</sup> Bergische Universität Wuppertal; <sup>4</sup> Izmir Institute of Technology, Izmir, Türkei	

## Kurzvorträge Posterblock 2

<b>8 Non-fully gold nanohole array fabricated by nanoimprint lithography.....</b>	<b>41</b>
R. Zhu <sup>1,2</sup> , M. Prömpers <sup>1</sup> , A. Offenhäusser <sup>1</sup> , D. Mayer <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Forschungszentrum Jülich GmbH; <sup>2</sup> RWTH Aachen University, Aachen	
<b>9 CMOS-compatible fabrication of perforated membranes for filtration applications.....</b>	<b>45</b>
N. Brechmann <sup>1</sup> , M. Michel <sup>1</sup> , A. Pickhinke <sup>2</sup> , N. Schierbaum <sup>1</sup> , K. Seidl <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Fraunhofer IMS, Duisburg; <sup>2</sup> University of Duisburg-Essen	

<b>10 Tabakmosaikviren als „Nanocarrier“ zur Anbindung von Biomolekülen auf kapazitiven Feldeffektsensoren .....</b>	<b>50</b>
F. Vahidpour <sup>1</sup> , M. Welden <sup>1,2</sup> , A. Poghossian <sup>3</sup> , T. Wendlandt <sup>4</sup> , C. Wege <sup>4</sup> , M. Keusgen <sup>2</sup> , M. J. Schöning <sup>1,5</sup>	
<sup>1</sup> FH Aachen; <sup>2</sup> Philipps Universität Marburg; <sup>3</sup> MicroNanoBio, Düsseldorf; <sup>4</sup> Universität Stuttgart	
<sup>5</sup> Forschungszentrum Jülich GmbH	
<b>11 Modellierung und Experimente von Gold-Nanopartikel-modifizierten Feldeffektstrukturen .....</b>	<b>54</b>
T. Karschuck <sup>1,2</sup> , A. Poghossian <sup>3</sup> , P. H. Wagner <sup>2</sup> , M. J. Schöning <sup>1,4</sup>	
<sup>1</sup> FH Aachen; <sup>2</sup> KU Leuven, Belgium; <sup>3</sup> MicroNanoBio, Düsseldorf; <sup>4</sup> Forschungszentrum Jülich GmbH	
<b>12 Kompakter optischer Quantensensor basierend auf NV-Zentren in Diamant.....</b>	<b>58</b>
M. Bähr <sup>1,2</sup> , M. Jahn <sup>1</sup> , C. Heinze <sup>1</sup> , K. Neckermann <sup>1</sup> , J. Meijer <sup>2</sup> , T. Ortlepp <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt; <sup>2</sup> Leipzig University	
<b>13 In-plane thermal diffusivity measurements of Parylene C thin films with an RTD sensor array on a SiNx membrane .....</b>	<b>63</b>
F. Jiang <sup>1</sup> , L. Schaller <sup>1</sup> , M. Ryu <sup>2</sup> , J. Morikawa <sup>3</sup> , S. Ingebrandt <sup>1</sup> , X. T. Vu <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> RWTH Aachen University; <sup>2</sup> National Metrology Institute of Japan (NMIJ), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan; <sup>3</sup> School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, Japan	

## Kurzvorträge Posterblock 3

<b>14 Zinc Oxide Nanowire Arrays Growth on Patterned Silicon Substrate for Piezoelectric Energy Harvesting .....</b>	<b>66</b>
F. E. Anang <sup>1,2</sup> , Z. Wang <sup>1</sup> , J. Xu <sup>1</sup> , A. Schmidt <sup>1</sup> , M. Cain <sup>3</sup> , E. Peiner <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> TU Braunschweig; <sup>2</sup> Scientific Metrology Department, Ghana Standards Authority, Ghana;	
<sup>3</sup> Electrosciences Ltd, Farnham, Surrey, UK	
<b>15 Elektrodenfeld für die zweidimensionale Charakterisierung nanostrukturierter Materialien.....</b>	<b>71</b>
U. Pliquett, C. Gansauge, D. Echtermeyer, Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V., Heilbad Heiligenstadt	
<b>16 Herstellung flexibler Foliensysteme durch Flip-Chip Bonden gedünnter Chips auf Kontakt-pads mit Nanodrähten.....</b>	<b>76</b>
B. Albrecht <sup>1</sup> , U. Passlack <sup>1</sup> , C. Harendt <sup>1</sup> , F. Weißenborn <sup>2</sup> , O. Birlem <sup>2</sup> , S. Quednau <sup>2</sup> , J. N. Burghartz <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Institut für Mikroelektronik IMS CHIPS, Stuttgart; <sup>2</sup> NanoWired GmbH, Gernsheim	
<b>17 Modellbasiertes Reaktives Fügen.....</b>	<b>81</b>
A. Belguanche <sup>1</sup> , A. Schumacher <sup>2</sup> , N. Desch <sup>1</sup> , A. Benachour <sup>1</sup> , J. Böttcher <sup>3</sup> , G. Dietrich <sup>3</sup> , E. Pflug <sup>3</sup> , I. Spies <sup>2</sup> , P. Meyer <sup>2</sup> , B. Folkmer <sup>2</sup> , S. Knappmann <sup>2</sup> , P. Farber <sup>1</sup> , J. Gräbel <sup>1</sup> , M. Lake <sup>1</sup> , A. Dehé <sup>2</sup>	
<sup>1</sup> Hochschule Niederrhein; <sup>2</sup> Hahn-Schickard, Villingen-Schwenningen; <sup>3</sup> Fraunhofer IWS, Dresden	
<b>18 Membranbasierte Drucksensoren basierend auf Nanogranularen Tunnelwiderständen für medizinische Anwendungen.....</b>	<b>87</b>
A.-K. Klein, T. Goschurny, P. Bieschke, A. Kaya, NanoScale Systems, Nanoss GmbH, Darmstadt	
<b>19 Numerical Sensitivity Analysis of Microelectrodes for Multi-Local Impedance Measurements on Needles.....</b>	<b>90</b>
J. Liu, Ö. Atmaca, T. J. Ly, P. P. Pott, University of Stuttgart	

<b>20 Erhöhung des Technologie-Reifegrades von Silicium-Gras zur Breitbandigen Entspiegelung von Siliciumoberflächen.....</b>	<b>95</b>
M. Hillebrand <sup>1</sup> , A. C. Thewes <sup>1</sup> , M. Hoffmann <sup>1</sup> , L. Bindel <sup>2</sup> , A. Isserstedt-Trinke <sup>2</sup> , S. Biermann <sup>2</sup> , S. Gaßner <sup>3</sup> , C. Travan <sup>3</sup> , U. Glock <sup>3</sup>	
<sup>1</sup> Ruhr-Universität Bochum; <sup>2</sup> Micro-Hybrid Electronic GmbH, Hermsdorf; <sup>3</sup> Infineon Technologies AG, Neubiberg	

## Kurzvorträge Posterblock 4

<b>21 Comparative study of wafer-scale Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> layers made by thermal and plasma-enhanced ALD.....</b>	<b>100</b>
L. Willeke <sup>1</sup> , J. Jagosz <sup>1</sup> , N. Gerke <sup>1</sup> , P. Plate <sup>2</sup> , M. Hoffmann <sup>1</sup> , C. Bock <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Ruhr-Universität Bochum; <sup>2</sup> Sentech Instruments GmbH, Berlin, Germany	
<b>22 Plasmonic Metamaterial Absorber for Multispectral MWIR Microbolometers.....</b>	<b>105</b>
A. Litke <sup>1</sup> , E. Zakizade <sup>1</sup> , M. Michel <sup>1</sup> , D. Dittrich <sup>1</sup> , S. Weyers <sup>1</sup> , A. Lena Schall-Giesecke <sup>1,2</sup>	
<sup>1</sup> Fraunhofer IMS, Duisburg, <sup>2</sup> University of Duisburg-Essen, Duisburg	
<b>23 Miniaturisierte kapazitive Feldeffekt-Sensoren mit atomlagenabgeschiedenem Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf ultradünnen Isolatoren.....</b>	<b>108</b>
H. Iken <sup>1</sup> , A. L. Johnen <sup>1</sup> , D. Molinnus <sup>1,2</sup> , B. Richstein <sup>2</sup> , L. Hellmich <sup>2</sup> , A. Poghossian <sup>3</sup> , J. Knoch <sup>2</sup> , M. J. Schöning <sup>1,4</sup>	
<sup>1</sup> FH Aachen; <sup>2</sup> RWTH Aachen University, <sup>3</sup> MicroNanoBio, Düsseldorf; <sup>4</sup> Forschungszentrum Jülich GmbH	
<b>24 Effective MEMS Manufacturing Using Vapor HF Etch Processing Illustrated by Means of a Sterilization Cycle Counter .....</b>	<b>114</b>
N. Baum <sup>1</sup> , R. Vora <sup>2</sup> , G. Endress <sup>2</sup> , I. Spies <sup>3</sup> , D. Hoffmann <sup>3</sup> , H. Trautner <sup>3</sup> , C. Blattert <sup>2,3</sup> , A. Dehé <sup>3</sup> , D. Anderson <sup>4</sup> , T. O'Hara <sup>4</sup>	
<sup>1</sup> veonis Technologies GmbH, Puchheim; <sup>2</sup> Albert-Ludwigs-University Freiburg; <sup>3</sup> Hahn-Schickard, Villingen-Schwenningen; <sup>4</sup> memstar Ltd., Livingston, UK	
<b>25 Plasmaunterstützte Atomlagenabscheidung (ALD) von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> für Isolationsschichten in EWOD-Systemen .....</b>	<b>118</b>
P. Conrad, L. Willeke, M. Hoffmann, Ruhr-Universität Bochum	
<b>26 Fabrication of distributed bragg reflectors to reduce coupling losses of photonic circuits.....</b>	<b>123</b>
M. L. Vermeer, N. K. Alhareeb, H. K. Trieu, T. Lipka, Hamburg University of Technology	
<b>27 Glass-on-Glass Integrated Optofluidic Sensor based on a-Si:H Ring Resonators for Lab-on-Chip Applications .....</b>	<b>127</b>
N. K. Alhareeb, M. L. Vermeer, L. Rennpferdt, H. K. Trieu, T. Lipka, Hamburg University of Technology	